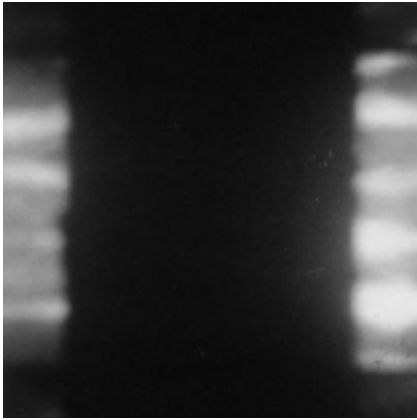


リジットフレキシブル基板対応 無電解銅めっきプロセス

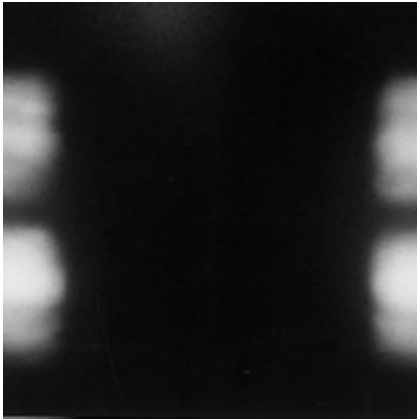
【概要】

リジットフレキシブル基板対応無電解銅めっきプロセスは、材質構成がことなるリジットフレキシブル基板に対応した無電解銅めっきプロセスです。ケーブル部分となるポリイミド表面への密着性とスルホール被覆を両立させた高品質な表面処理プロセスを提供します。

【FR-4基板のバックライト写真】



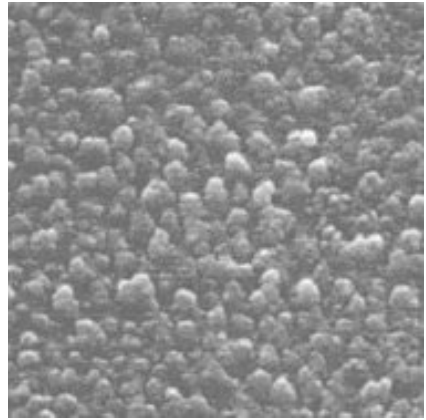
【FR-4基板のバックライト写真】



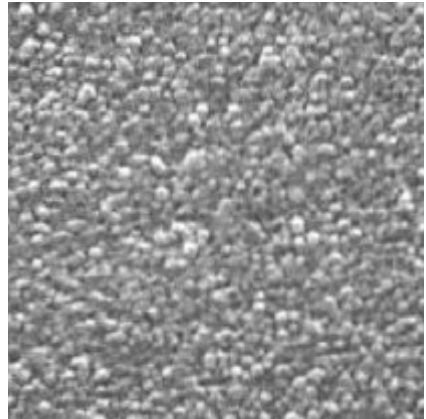
【特徴】

- ① 被覆性に優れたロッセル塩浴タイプの無電解銅めっき浴です。
- ② 細かい析出粒子のため、ポリイミド上での密着性に優れ、フクレ・ハガレが発生しにくいプロセスです。
- ③ ポリイミドを含むリジットフレキシブル基板等での良好なカバーリング性能を有しております。
- ④ 通常のFR-4材等の基板にも使用できるため、混在ラインとしても使用できます。
- ⑤ 低温、低アルカリ浴であるためポリイミド層の攻撃防止に有効です。

【通常の無電解銅めっきでの析出粒子】



【RF用無電解銅めっきでの析出粒子】

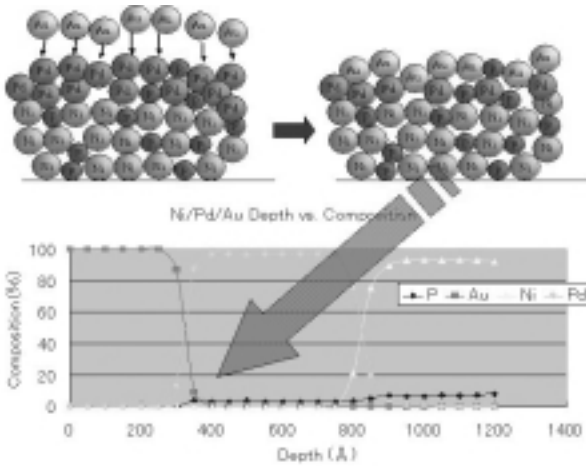


無電解ニッケル／無電解パラジウム／ 置換金めっきプロセス PAUROBOND

【概要】

パウロボンドプロセスは無電解ニッケル上にパラジウム／金皮膜を形成するプロセスです。ニッケル皮膜のバリアー層として、パラジウム皮膜を形成し、その後、良好なパラジウムの拡散による高品質な表面処理プロセスを提供します。

【パウロボンドプロセスの特徴】



【特徴】

- ① 無電解パラジウムめっき皮膜は、ニッケル皮膜を腐食する置換金めっきに対する保護皮膜として有効です。
- ② 無電解パラジウムめっき皮膜は、はんだ接合前のバリアー層として有効です。
- ③ 無電解パラジウム（リン含有）皮膜はリンの含有量が少ないため、リンリッチ層の形成がありません。

- ④ 無電解パラジウムめっきは、金属表面のみへ析出するため優れた析出選択性があります。
- ⑤ パラジウム皮膜中のリン含有率は3%前後であり、耐食性が良好です。
- ⑥ 無電解ニッケル／無電解パラジウム／置換金めっきで形成された皮膜は、優れたはんだ濡れ性、優れたはんだ接続信頼性および優れたワイヤーボンド性を有しています。
- ⑦ 優れた浴安定性および容易な浴管理で安定した生産を行うことができます。
- ⑧ 無電解パラジウムめっき浴は、バッファースystemによる浴および槽のメンテナンスが容易です。

金めっき剥離後の表面

